

2017年5月12日

## 銅張積層板、プリプレグおよび内層回路入り多層基板材料の 価格改定について

パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社は、電子回路基板材料として販売している銅張積層板、プリプレグおよび内層回路入り多層基板材料(当社製品名:プレマルチ)の価格を再度改定致します。

銅箔価格の上昇を背景に、当社は2017年1月に銅張積層板について+10%、内層回路入り多層基板材料について+5%の価格改定を実施致しましたが、その後も銅箔は世界的に需給が逼迫しており、その価格は前回の価格改定時の想定を超える上昇となっています。加えて、世界的な電子回路基板の旺盛な需要を背景に、銅箔と同じく電子回路基板材料の原材料であるガラスクロス、樹脂などについても需給が逼迫し、価格が高騰しています。

当社では、原材料費の増加分を吸収すべく、一層の製造の合理化や費用削減などに、全力を上げて継続して努めてまいりましたが、電子回路基板材料の原材料の価格上昇分の全てを自助努力と前回価格改定分で吸収することが困難な状況になっています。このような需給バランスの逼迫が当面継続すると予想されることから、製品の安定供給を図る為にも、原材料価格の上昇分の一部を以下の通り製品価格に再度反映させていただくこととなりました。

### ■価格改定対象製品と現行価格に対する改定幅

対象製品	現行価格に対する改定幅
銅張積層板	現行価格の+10%
プリプレグ、接着絶縁シート	現行価格の+10%
内層回路入り多層基板材料 (当社製品名:プレマルチ)	現行価格の+5%

### ■実施時期

2017年6月1日出荷分より

### 【お問合せ先】

オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 電子材料事業部  
[https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?](https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?field_contact_group=2201&field_contact_lineup=3248&ad=press20170512)  
[field\\_contact\\_group=2201&field\\_contact\\_lineup=3248&ad=press20170512](https://industrial.panasonic.com/cuif/jp/contact-us?field_contact_group=2201&field_contact_lineup=3248&ad=press20170512)

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。  
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。